



東京エレクトロン デバイス株式会社

[第2四半期] 第 33 期
中間報告書
平成29年4月1日 → 平成29年9月30日

証券コード 2760



株主の皆様へ

株主の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社第33期中間報告書（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）として事業の概況等をご報告いたします。

代表取締役社長 徳重 敦之

当中間期（第2四半期）の経営成績

当中間期におけるわが国経済は、企業収益に改善が見受けられ、個人消費が持ち直すなど緩やかな回復基調が続いております。当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の業績については、半導体及び電子デバイス事業の寄与等により、売上高764億3千1百万円（前年同期比26.9%増）、営業利益10億6百万円（前年同期は営業損失1億2千8百万円）、経常利益9億8千3百万円（前年同期比211.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益6億9千9百万円（前年同期比200.0%増）となりました。

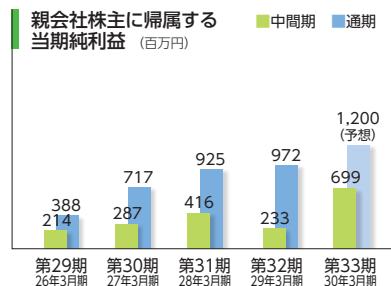
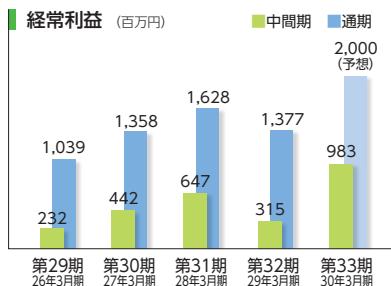
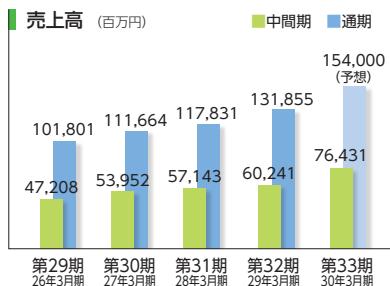
業績予想

平成30年3月期の通期連結業績予想については、半導体及び電子デバイス事業における製品販売が好調に推移する中、スマートフォン関連の商権が寄与していることに加え、今後も引き続き産業機器や自動車向け半導体製品の需要が高水準で推移する見込みであることなどから、下記の通り見直すことといたしました。

平成30年3月期連結業績予想数値の修正（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

	売上高 百万円	経常利益 百万円	親会社株主に帰属する当期純利益 百万円	1株当たり当期純利益 円 銭
前回（平成29年4月26日）発表予想（A）	140,000	1,500	1,000	99.27
今回（平成29年9月28日）発表予想（B）	154,000	2,000	1,200	119.12
増減額（B-A）	14,000	500	200	—
増減率（%）	10.0	33.3	20.0	—
（参考）前期実績（平成29年3月期）	131,855	1,377	972	96.71

連結業績ハイライト



株式会社アパール長崎を連結子会社化

当社は、自社ブランド『inrevium(インレビウム)』で提供する当社製品の開発製造機能を強化することを目的として、電子機器の開発・設計・製造・販売を行う株式会社アパール長崎(以下、アパール長崎)を平成29年7月に連結子会社化いたしました。アパール長崎は、半導体製造装置関連分野を主力としながら、現在、CTI(電話とコンピュータを連携して利用する技術)製品に続く新たな事業の確立を目指し、スマートエネルギー関連事業に注力しております。当社のもと従来のコア技術を生かしながら引き続き同社製品の開発・販売を行うことで、新規事業の確立を加速することが可能になります。なお、平成30年3月期第2四半期より当社の業績に寄与いたします。



株式の状況

- 株式取得日
平成29年7月1日
- 取得株式数
174,000株
- 議決権所有割合
74.04%
- 取得価額
1,392百万円

株主還元について

当社は株主重視を経営の最重要事項の一つと位置付けており、株主の皆様に対する利益還元と経営基盤を強化するための内部留保とのバランスを考慮しつつ、株主還元の充実を図ることを基本方針といたします。

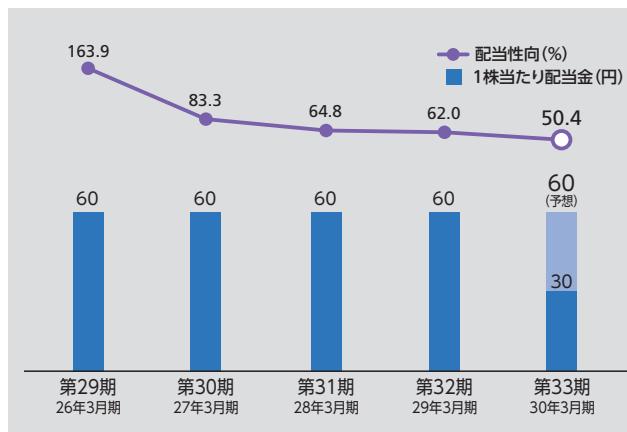
継続的かつ安定的な配当実施に加え、業績を反映した利益還元の視点に基づく配当政策として、配当性向の目安は親会社株主に帰属する当期純利益の50%以上、かつ、資本効率を示すROEと連動するDOE(株主資本配当率)*は2.5%を下限としてまいります。

また、自己株式の取得については、資本政策や経営環境の変化を勘案し、機動的・弾力的に実施してまいります。

当中間期の1株当たり配当金は30円とさせていただきます。期末の1株当たり配当金は30円、通期で60円を予定しております。

※DOE(株主資本配当率)

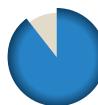
株主資本に対し、どの程度の配当が利益還元として実施されているのかを示す指標であり、「配当性向×ROE」という算定式によって導き出されます。



※1株当たり配当金は平成25年10月1日の株式分割(1株→100株)を反映した金額にて記載しております。

半導体及び電子デバイス事業

売上高構成比
89.6%



売上高 68,468百万円

自動車の電動化や自動運転化による1台あたりの半導体搭載量の増加やデータセンター及び産業機器等向けに半導体の需要が好調であることなどから、半導体市場は引き続き活況を呈しており、一部製品では供給不足が続いております。

このような状況のもと、当社におきましては工場の自動化に貢献する産業機器や自動車を中心に幅広い分野で半導体製品の販売が大幅に伸長したことに加え、スマートフォン関連の商権が寄与したことなどから、売上高は684億6千8百万円(前年同期比29.5%増)、セグメント利益(経常利益)は6億9千1百万円(前年同期比445.4%増)となりました。

品目別売上高構成比



①汎用IC

色々な用途に
使用されるIC



主な商品と仕入先

アナログIC (テキサス・インスツルメンツ社、アナログ・デバイス社 (旧リニアテクノロジー社)*)

主な最終製品

カーナビゲーション、FA機器、医療機器、OA機器

②専用IC

特定用途向けに
作られるIC



主な商品と仕入先

DLP用 (テキサス・インスツルメンツ社)
通信用 (ブロードコム社、アナログ・デバイス社*)
画像用 (ピクセルワークス社)

主な最終製品

液晶プロジェクタ、スマートフォン、FA機器

③プロセッサ

コンピュータの
頭脳として演算・
制御機能を持つIC



主な商品と仕入先

マイクロプロセッサ (NXP Semiconductors、インテル社)
DSP (テキサス・インスツルメンツ社)

主な最終製品

携帯電話基地局、カーナビゲーション、
OA機器、医療機器

*アナログ・デバイス社の日本における販売代理店政策に関する方針と当社の販売戦略との方向性に隔たりが生じたため、双方合意の上、平成30年1月31日付で販売代理店契約を解消することといたしました。当期の業績に与える影響は軽微であります。

コンピュータシステム関連事業

売上高構成比
10.4%



売上高 7,963百万円

クラウドコンピューティングの活用等が増加しており、クラウド及びデータセンター事業者が提供するサービスの利用拡大が見込まれております。セキュリティのほか、AI(人工知能)やIoT(Internet of Things)等の分野にも注目が集まっております。

このような状況のもと、当社におきましてはクラウド及びデータセンター事業者のサービス基盤拡充に伴い、ネットワーク機器等の販売やその環境を安定的に維持するための保守ビジネスが堅調に推移したことなどから、売上高は79億6千3百万円(前年同期比7.8%増)、セグメント利益(経常利益)は2億9千1百万円(前年同期比54.6%増)となりました。

品目別売上高構成比



inrevium

自社ブランド商品のご紹介



メッシュ無線を用いた温湿度センサー

- アナログ・デバイス社(Dust Networks®)の SmartMesh IP製品を搭載した温湿度センサー
- 医薬品、食品などの製造工場、物流倉庫向け
- IoT向けにMicrosoft Azureとのパッケージでも提供

Microsoft
AzureMicrosoft
Power BI Pro

TED REAL IoT

④光学部品

電気を光に変換して
使用する電子部品

主な商品と仕入先

LED、フォトカプラ (ブロードコム社)

主な最終製品

スマートフォン、産業機器、車載機器

⑤カスタムIC

お客様の仕様
に応じて作られるIC

主な商品と仕入先

ASIC (株)ソシオネクスト
PLD (ラティスセミコンダクター社)
デザインサービス (インレヴィアム) **inrevium**

主な最終製品

医療機器、FA機器、通信機器、OA機器、
カーナビゲーション

⑥メモリIC

記憶用IC



主な商品と仕入先

FRAM、フラッシュメモリ(サイプレス セミコンダクタ社)

主な最終製品

FA機器、カーナビゲーション、医療機器

①ネットワーク関連機器

インターネットの接続負荷の分散、
セキュリティ強化

主な仕入先

F5ネットワークス社
アリストネットワークス社

②ストレージ関連機器

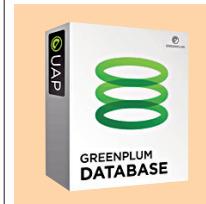
大容量データの記憶、
統合技術によるコスト削減

主な仕入先

プロケード
コミュニケーションズ
システムズ社
ピュアストレージ社
DELL EMC社

③ソフトウェア他

データ管理を行うデータベース



主な仕入先

日本オラクル社
ニュータニックス社

連結財務諸表

中間(第2四半期) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前 期	当中間期
	(平成29年3月31日現在)	(平成29年9月30日現在)
流動資産	68,768	76,637
固定資産	4,940	5,417
資産合計 POINT1	73,708	82,054
流動負債	33,913	44,354
固定負債	16,867	13,933
負債合計 POINT2	50,780	58,287
純資産合計 POINT3	22,928	23,766
負債及び純資産合計	73,708	82,054

POINT1 資産合計

総資産は820億5千4百万円となり、前期末に比べ83億4千5百万円の増加となりました。これは主に、商品及び製品が増加したことによります。

中間(第2四半期) 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前中間期	当中間期
	(平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで)	(平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで)
売上高	60,241	76,431
売上原価	53,855	68,151
売上総利益	6,386	8,279
販売費及び一般管理費	6,515	7,273
営業利益又は営業損失(△)	△ 128	1,006
営業外収益	521	71
営業外費用	76	94
経常利益	315	983
特別利益	0	46
特別損失	3	6
法人税等	79	308
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	15
親会社株主に帰属する四半期純利益	233	699

POINT2 負債合計

負債総額は582億8千7百万円となり、前期末に比べ75億7百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによります。

中間(第2四半期) 連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円)

科 目	前中間期	当中間期
	(平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで)	(平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 540	△ 3,473
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 198	△ 759
財務活動によるキャッシュ・フロー	242	4,894
現金及び現金同等物の期首残高	2,637	2,433
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,103	3,097

POINT3 純資産合計

純資産は237億6千6百万円となり、前期末に比べ8億3千8百万円の増加となりました。

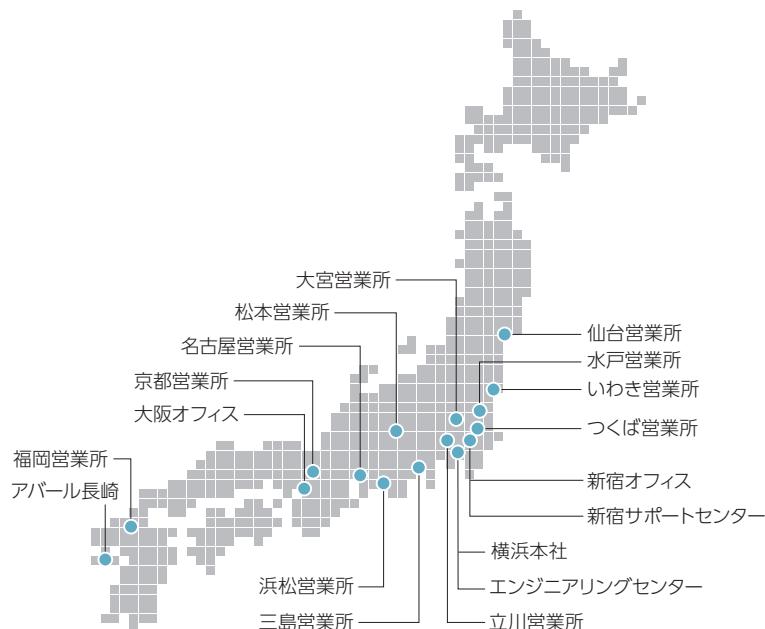
(注) 連結財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

会社の概要 (平成29年9月30日現在)

会社概要

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	昭和61年3月3日
資本金	24億9千5百万円
従業員数	連結：1,093名
本社	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア
子会社	パネトロン株式会社 株式会社アパール長崎 東電電子部品亞太區有限公司 (TED APAC) 上海華桑電子零件貿易有限公司 (TED上海) TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. (TEDシンガポール) TOKYO ELECTRON DEVICE (THAILAND) LIMITED (TEDタイ) inrevium AMERICA, INC. (インレビウムアメリカ) TOKYO ELECTRON DEVICE CN AMERICA, INC. (TED CNアメリカ)
関連会社	ビステル株式会社 Fidus Systems Inc. 上海新致華桑電子有限公司 無錫新致華桑電子有限公司

主な国内拠点



役員等

取締役

取締役会長	久我 宣之
代表取締役社長	徳重 敦之
代表取締役	長谷川 雅巳
取締役	上小川 昭浩
取締役	佐伯 幸雄
取締役	篠田 一樹
取締役(非常勤)	常石 哲男
社外取締役	石川 國雄
社外取締役	不破 久温

監査役

常勤監査役	河合 信郎
常勤監査役	中村 隆
社外監査役	福森 久美
社外監査役	成瀬 圭珠子

執行役員

社長	徳重 敦之
執行役員常務	長谷川 雅巳
執行役員常務	上小川 昭浩
執行役員常務	佐伯 幸雄
執行役員	篠田 一樹
執行役員	初見 泰男
執行役員	浅野 升徳
執行役員	上善 良直
執行役員	安村 達志
執行役員	岩田 郁雄
執行役員	土肥 健史

株式情報 (平成29年9月30日現在)

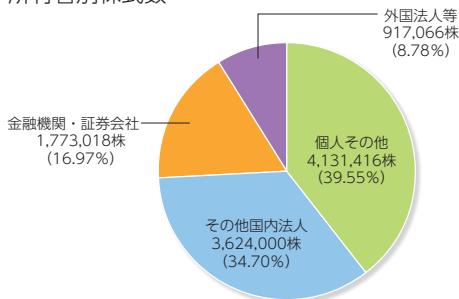
株式の状況

- 発行可能株式総数 25,600,000株
- 発行済株式総数 10,445,500株
- 株主数 6,503名
- 大株主

株主名	持株数	出資比率	
		株	%
東京エレクトロン株式会社	3,532,700		33.82
東京エレクトロンデバイス社員持株会	429,515		4.11
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	238,700		2.28
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	236,000		2.25
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口・75722口)	191,100		1.82

株式分布状況

●所有者別株式数



※自己株式35株は、「個人その他」に含めております。



半導体及び電子デバイス事業にて認証取得



この報告書は、森林認証を受けたFSC®認証紙および、低VOCの植物油インキを使用しています。



株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
 定時株主総会 毎年6月
 基準日 定時株主総会については、毎年3月31日
 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
 配当支払株主確定日 期末配当 毎年3月31日
 中間配当 毎年9月30日
 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社
 (郵便物送付先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 (電話照会先) 三井住友信託銀行株式会社証券代行部
 0120-782-031 (フリーダイヤル)
 同取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
 公告の方法 電子公告
 上場金融商品取引所 東京証券取引所 市場第一部
 (証券コード 2760)

●「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をされる株主様は大切に保管ください。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。

コーポレートメッセージ



「Connect Beyond」は、ステークホルダーの皆さまの期待と信頼に応えるため、あらゆる既存概念を超えて、皆さまと共に新たな価値の創造に挑戦するという私たちの姿勢を表しています。

